

無電解金めっき、電解金めっき薬品

商品名	特徴	品番・作業条件	荷姿	用途
MN-AUA	<ul style="list-style-type: none"> ■ 置換金 ● 密着性がよい ● 厚付け金めっきの下地 ● 色調がよい(レモンイエロー) ● 下地ニッケルはSフリーがよい 	MN-AUA 250~500ml/ℓ KAu(CN) ₂ 2g/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ RoHS対応 ● 電子部品 ● 機構部品
MN-AUB	<ul style="list-style-type: none"> ■ 置換金 ● ニッケル、金との密着性大 ● 色調がよい(レモンイエロー) ● Ni-B用 	MN-AUB 200~500ml/ℓ KAu(CN) ₂ 2g/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電子部品 ● フリップチップ ● PCB
MN-AUC	<ul style="list-style-type: none"> ■ セラミック、PCB用置換金 ● ボールシェア強度が安定 	MN-AUC 250~500ml/ℓ KAu(CN) ₂ 1.5g/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ CAT-2000プロセス ● PCB、FPC
MN-AUE	<ul style="list-style-type: none"> ■ PCB用置換金 ● ボールシェア強度が安定 ● 下地ニッケルはリンデン52を用いる 	MN-AUE 50~250ml/ℓ 1%KCN 1~5ml/ℓ KAu(CN) ₂ 1~4g/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ CAT-2000-1プロセス ● PCB、FPC
MN-AUG	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電子部品用置換金 ● ボールシェア強度が安定 ● めっき液が安定 ● 無電解厚付Auの下地に適する ● 下地ニッケルはリンデン203系を用いる 	MN-AUG 100~500ml/ℓ 1%KCN 2~10ml/ℓ KAu(CN) ₂ 1~4g/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ RoHS対応 ● 電子部品 ● 機構部品
MN-AUI MN-AUIP	<ul style="list-style-type: none"> ■ 置換金 ● 密着性がよい ● ボールシェア強度が安定 ● 粉末タイプもあります(MN-AUIP) 	MN-AUI 原液使用~200ml/ℓ KAu(CN) ₂ 1.5g/ℓ	20L 20kg	<ul style="list-style-type: none"> ○ RoHS対応 ● 電子部品 ● LTCC基板 ● PCB、FPC
MN-AUN (中性、ノーシアン)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 無電解(置換/還元)金 ● 亜硫酸金浴 ● めっき厚 0.03~1.0μm ● 浴の安定性がよい 	原液使用 Au含有液 2g/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ RoHS対応 ● 電子部品 ● 半導体厚付け用 ● PCB
GOLD8 GOLD8L (自己触媒型)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 高速厚付け用無電解金めっき液 ● めっき液が安定 ● めっき速度が速い 1~3μm/h at 75℃ ● 連続使用ができる(5~10日間) ● ボンディング性にすぐれる ● Auコンテンツ99.99% S.G19.3 ● アルカリタイプ ● GOLD8LはRoHS対応 	GOLD8-M (GOLD8L-M) 250~500ml/ℓ GOLD8-A (GOLD8L-A) 5g/ℓ KAu(CN) ₂ 2~4g/ℓ	20L 1kg	<ul style="list-style-type: none"> ○ RoHS対応(GOLD8L) ● ボンディング金 ● ICパッケージ ● チップキャリアー ● 電子部品 ● 機構部品 ● PCB
GOLD9 GOLD9L (自己触媒型)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 高速厚付け用無電解金めっき液 ● めっき液が非常に安定 ● 従来より低温でめっき速度が速い 1~3μm/h at 70℃ ● 連続使用ができる(5~10日間) ● ボンディング性にすぐれる ● ファインパターンに対応 ● 皮膜特性にすぐれる ● アルカリタイプ ● GOLD9LはRoHS対応 	GOLD9-M (GOLD9L-M) 250~500ml/ℓ GOLD9-A (GOLD9L-A) 5~7.5g/ℓ KAu(CN) ₂ 2~4g/ℓ	20L 1kg	<ul style="list-style-type: none"> ○ RoHS対応(GOLD9L) ● ボンディング金 ● ICパッケージ ● チップキャリアー ● 電子部品 ● 機構部品 ● PCB

商品名	特徴	品番・作業条件	荷姿	用途
GOLD10 GOLD10L (自己触媒型)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 高速厚付け用無電解金めっき液 ● めっき液が安定 ● めっき速度が速い 1~3μm/h at 75℃ ● 連続使用ができる(5~10日間) ● 高耐熱性を持つ ● ボンディング性にすぐれる ● ファインパターンに対応 ● アルカリタイプ ● GOLD10LはRoHS対応 	GOLD10-M (GOLD10L-M) 250~500ml/ℓ GOLD10-A (GOLD10L-A) 5~7.5g/ℓ KAu(CN) ₂ 2~4g/ℓ	20L 1kg	<ul style="list-style-type: none"> ○ RoHS対応(GOLD10L) ● ボンディング金 ● ICパッケージ ● チップキャリア ● 電子部品 ● 機構部品 ● PCB
GOLD8C-2 (銅上に直接めっき)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 銅素地用無電解厚付け金めっき液 ● Cu上に直接厚付け金めっきができる ● Ni上も同様に厚付けできる ● 液の安定性がよい、分解しない ● 美しい色調とボンディング性がある ● アルカリタイプ 	GOLD8C-1 処理後 ↓ GOLD8C-2 500ml/ℓ KAu(CN) ₂ 5~8g/ℓ	20L 20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cu上のめっき ● 小物めっき
ゴールドESTA	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電解金ストライクめっき液 ● つきまわりがよい ● 密着がよい 	原液使用 KAu(CN) ₂ 1.5g/ℓ	20L	○ 金ストライク用
ゴールドEPU	<ul style="list-style-type: none"> ■ 高純度電解金めっき液 ● 純度99.99% ● 硬度50~70Hv ● ボンディング性がよい 	原液使用 KAu(CN) ₂ 5~17g/ℓ	20L	○ ワイヤーボンディング用
ゴールドEC-10 EC-10H	<ul style="list-style-type: none"> ■ 硬質電解金めっき浴一般用 ● 純度99.99% ● 均一性にすぐれて、緻密、耐食性良好 ● コストが安い、光沢がよい 	原液使用 KAu(CN) ₂ 5~17g/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ コネクター、PCB ● 接点 ● 半導体工業 ● 精密機械工業
AU-505	<ul style="list-style-type: none"> ■ 金めっき密着改良剤 ● Ni-Auめっき間の密着を改良する 	原液使用	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ PCB ● ハーメチックシール部品